

## CAE Molding Conference 2009 巡迴研討會應用論文徵選活動

各位 親愛的用戶您好：

由台灣區電腦輔助成型交流技術協會(ACMT)主辦、科盛科技協辦的一年一度「**CAE Molding Conference 2009 巡迴研討會**」又將來臨，今年會中將邀集國內外的領導廠商與學研界專家與會暢談 CAE Molding 相關技術。配合此次盛會，大會保留傳統持續舉辦「論文徵稿」活動，通過評選的論文將收錄於 CAE Molding Conference 2009 論文集，並頒予投稿證明獎狀感謝您對於此產業界的貢獻，歡迎大家踴躍投稿分享您卓越的研究與應用成果！詳細活動資訊如下：

- **徵稿對象：**塑膠加工與 CAE 相關之業者與學術研究人員
- **徵文範圍：**(1) 電腦輔助工程(CAE)設計製造應用整合  
(2) 最新塑膠加工成型技術應用成果
- **評選辦法：**將由大會評選委員會進行文件審核，通過評選的論文即可刊載於 CMC2009 論文集
- **投稿方式：**(1) 中文摘要：2009 年 5 月 22 日前提供  
(2) 中文全文：2009 年 6 月 30 日前提供
- **其他事項：**
  - 入選論文將會收錄至本次研討會論文集或論文資料光碟中
  - 論文檔將於研討會後放至 ACMT 網站討論區中供網站 ACMT 會員下載

### 投稿意願表

ACMT 協會與科盛科技懇請您能共襄盛舉並投稿分享，下表為投稿意願表，如有意願請填寫完後撕下交給與您接洽的業務或回傳科盛科技，感謝配合。

公司名稱			
投稿者姓名		部門/職稱	
公司電話		傳真電話	
E-mail			
日期	西元	年	月 日

- ☉ 填寫完畢後請回傳 ACMT 協會留存，謝謝您！
- ☉ 承辦窗口：科盛科技\_曾宏志 先生 Tel：03-5600199 ext.703 / Fax：03-5600198
- ☉ 附註：所發表或登錄文章之著作財產權以及相關權責歸屬屬原作者所有。

尚此敬頌

研 安